

Raise3D Pro2系列 技术规格

型号	Pro2 Plus		Pro2 Plus 引领版	
尺寸	打印尺寸 (长 × 宽 × 高)			
	使用单喷头打印时	使用双喷头打印时	使用单喷头打印时	使用双喷头打印时
	305 × 305 × 605 mm	280 × 305 × 605 mm	305 × 305 × 605 mm	280 × 305 × 605 mm
	机身尺寸 (长 × 宽 × 高)			
	620 × 590 × 1105 mm		620 × 590 × 1105 mm	
电源	输入	通用100-240 V, 50/ 60 Hz 230 V @ 3.3 A		
	输出	24 V DC, 600 W		
通用	技术原理	FFF 熔丝制造技术		
	挤出系统	电动双喷头挤出系统		
	耗材直径	1.75 mm		
	XYZ轴步长精度	0.78125, 0.78125, 0.078125 micron		
	打印速度	30-150 mm/s		
	打印平台	加热铝制底板, 磁吸固定		
	打印平台最高温度	110°C		
	加热板材质	硅胶		
	打印平台校平	预校准校平		
	断电续打	支持		
	断料检测	支持		
	支持材料	PLA / ABS / PC / TPU / TPE / NYLON (尼龙) PETG / ASA / PP / PVA / 玻纤增强 / 碳纤增强		
	层厚	0.01-0.25 mm		
	喷嘴直径	0.4 mm (默认), 0.2/ 0.6/ 0.8/ 1.0 mm (可选)		
	喷嘴最高温度	300°C		
	连接	Wi-Fi, LAN, USB 端口, 实时监控摄像头		
	噪音	< 50 dB (A) 打印时		
	建议运行环境	15-30°C, 相对湿度10-90%, 无结露		
	储存温度	-25°C至+55°C,, 相对湿度 10-90%, 无结露		
	技术认证	CB、CE、FCC、RoHS、RCM		
	空气过滤器	HEPA空气滤净系统		
软件	切片软件	ideaMaker		
	输入文件格式	STL/ OBJ/ 3MF/ OLTP		
	操作系统	Windows/ macOS/ Linux		
	输出文件格式	GCODE		
打印机控制	用户界面	7英寸触摸屏		
	网络	Wi-Fi, 以太网		
	屏幕分辨率	1024 × 600		
	运动主控芯片	Atmel ARM Cortex-M7 400 MHz FPU		
	逻辑控制芯片	Freescale i.MX6, Quad core 1Ghz ARM processor		
	内存	1 GB		
	闪存	16 GB		
	操作系统	嵌入式 Linux		
	端口	USB2.0 × 2, 以太网 × 1		